

2023年

电子元器件销售 行情分析与预判

正文目录

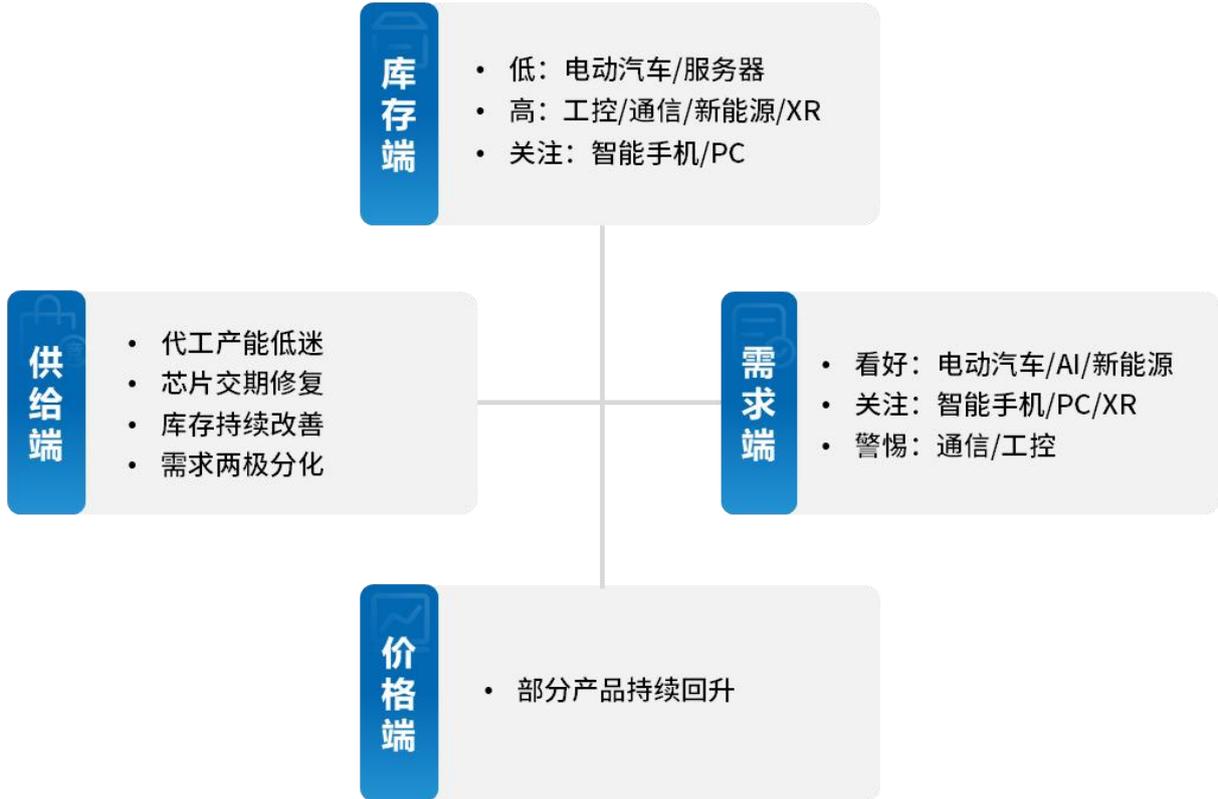
序章	2
一、2023 年半导体产业现状综述	2
1、供给修复，芯片交期/价格改善明显	2
2、市场复苏，半导体销售额走出低谷	4
3、投资回升，AI 和汽车等成资本热点	7
4、格局变化，地缘争端引发产业转移	9
二、2023 年采购分销年度回顾	10
1、年度供应链大事件及影响	10
2、头部厂商订单及库存情况	11
3、重点品牌交期及趋势分析	13
4、年度涨跌幅品类/厂商一览	13
三、2023 年半导体供应链梳理	15
1、制造：晶圆代工产能分化，先进制程价格上调	16
2、原厂：行业触底反弹，存储产品价格持续改善	17
3、分销：整体库存相对较高，营收回升趋势巩固	19
4、终端：需求呈现两级分化，看好 AI 和汽车增长	20
四、2024 年趋势展望	21
1、半导体销售恢复中高速增长，存储成关键	21
2、看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势	23
3、分销行业集中度提升，强者恒强趋势凸显	23
4、供应链波动风险持续，分销并购整合加速	24
免责声明	26

图表目录

图表 1: 2020-2023 年全球芯片交期回顾	3
图表 2: 2023 年主要芯片厂商交期及价格回顾	3
图表 3: 2023 年全球半导体销售额情况	4
图表 4: 2023 年全球半导体区域市场占比	5
图表 5: 2023-2024 年全球半导体区域市场增长情况	5
图表 6: 2023 年全球半导体细分产品占比	6
图表 7: 2023 年全球 Top10 半导体供应商市场份额	6
图表 8: 2023 年全球半导体投融资情况	8
图表 9: 2023 年全球半导体投融资分布 (按国家)	8
图表 10: 2023 年全球半导体投资热点	9
图表 11: 2023 年全球半导体产业正经历新一轮产业转移	10
图表 12: 2023 年半导体供应链值得关注大事件及影响回顾	10
图表 13: 头部企业订单及库存情况	11
图表 14: 年度市场热点品类及厂商一览	13
图表 15: 年度重点降价品类一览	13
图表 16: 年度重点涨价品类一览	15
图表 17: 2023 年半导体供应链梳理及 2024 年预测	15
图表 18: 2023 年主要晶圆代工厂产能利用率情况	16
图表 19: 2024 年头部晶圆代工厂价格预测	17
图表 20: 头部原厂库存 2023Q1 触顶下滑	18
图表 21: 2022Q1-2023Q4 各品类厂商平均库存走势图	18
图表 22: 头部分销商库存相对较高	19
图表 23: 2023Q3 以来头部分销商营收同比增速持续回正	19
图表 24: 全球半导体终端应用中消费类需求占大头	20
图表 25: 终端应用厂商平均库存走势及预测	21
图表 26: 2024 年全球半导体销售额增长预测	22
图表 27: 2024 年全球半导体细分品类增长预测	22
图表 28: 2024 年主要终端应用领域增长预测	23
图表 29: 2020-2023 年元器件分销行业头部厂商份额占比变化	24
图表 30: 元器件分销 TOP5 厂商份额占比	24

序章

至暗已过 晨曦初至



一、2023 年半导体产业现状综述

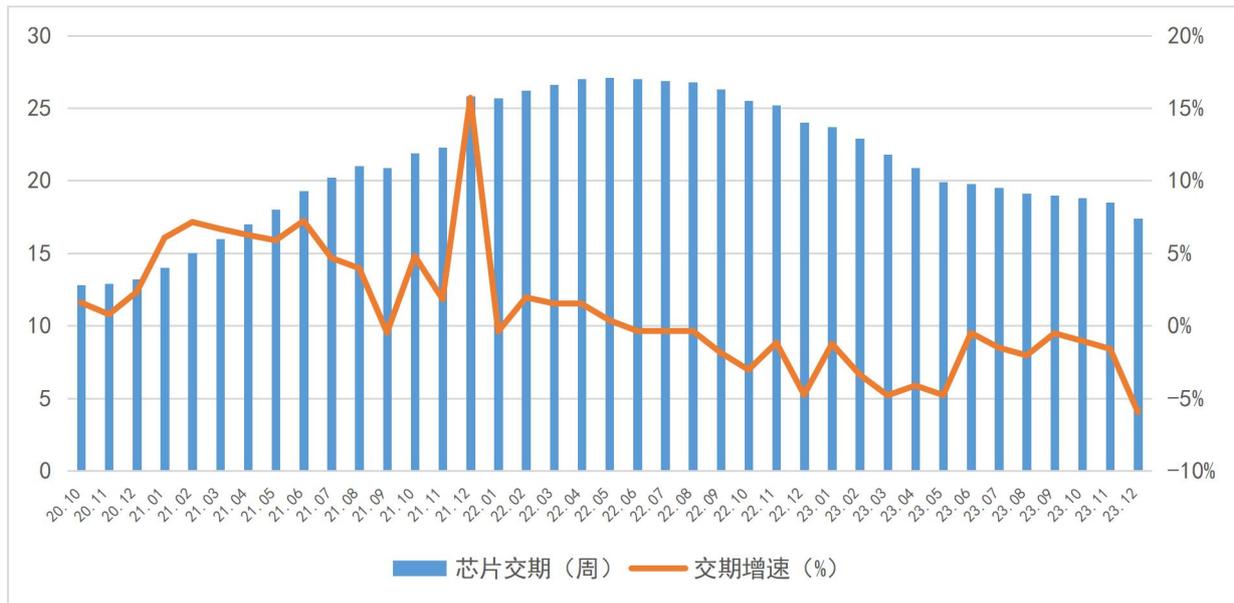
回顾 2023 年，宏观经济弱势运行、贸易冲突博弈持续、产业分化割裂严重等问题仍在延续，上半年全球半导体产业处于下行周期。下半年以来，随着终端需求温和复苏，各品类芯片交期和价格大幅修复，下游客户恢复正常提货节奏，行业逐步走出周期底部。当前，虽然全球半导体市场结构性分化依然存在，但 2024 年总体市场趋势向好，有望重回上升周期。

1、供给修复，芯片交期/价格改善明显

2023 年，全球芯片交期持续下降，芯片库存去化趋势良好，芯八哥判断当前基本处

于本轮周期底部区域。综合来看，行业库存调整周期接近尾声，需求成为未来增长关键。

图表 1：2020-2023 年全球芯片交期回顾



资料来源：SFG、芯八哥整理

从重点芯片供应商看，2023 年各细分品类货期及价格改善明显，但结构性分化依然存在。其中，以 TI、ADI 为代表的模拟芯片降幅较大，价格倒挂严重；三星电子、SK 海力士等 DRAM 和 NAND 芯片价格持续回升；Infineon、ST 等 MOSFET/IGBT 产品改善明显；ST、NXP 等消费/工业 MCU 价格进入筑底阶段，行情趋于稳定。

图表 2：2023 年主要芯片厂商交期及价格回顾

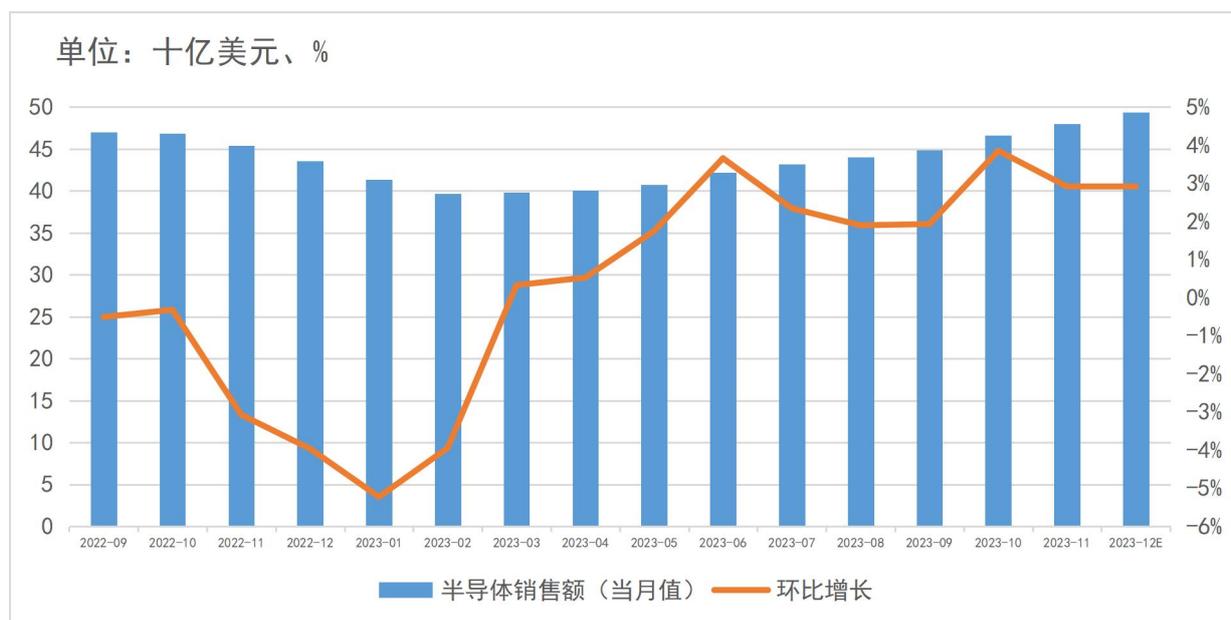
类别	厂商	22Q3		22Q4		23Q1		23Q2		23Q3		23Q4		
		交期趋势	价格趋势	交期趋势	价格趋势	交期趋势	价格趋势	交期趋势	价格趋势	交期趋势	价格趋势	交期趋势	价格趋势	
消费MCU	ST	紧缺	上升	紧缺	稳定	48	稳定	35-52	稳定	35-52	稳定	35-52	稳定	
	NXP	紧缺	上升	52	稳定	35-52	稳定	26-52	稳定	26-52	稳定	13-39	稳定	
汽车MCU	Infineon	配货状态	上升	配货状态	上升	配货状态	稳定	紧缺	稳定	紧缺	稳定	紧缺	稳定	
	NXP	配货状态	上升	紧缺	上升	35-52	稳定	35-52	稳定	35-52	稳定	18-52	稳定	
模拟-信号链	Microchip	30-40	稳定	30-40	稳定	30-40	稳定	30-40	稳定	30-40	稳定	4-10	稳定	
	ADI	20-30	稳定	20-31	稳定	20-30	稳定	20-30	稳定	15-20	稳定	15-20	上升	
模拟-电源链	TI	20-30	稳定	20-30	稳定	20-30	下降	14-30	下降	8-16	下降	8-16	稳定	
	Onsemi	35-42	上升	35-42	稳定	35-42	稳定	35-42	稳定	35-42	稳定	20-40	稳定	
	ST	40-50	上升	40-50	稳定	40-50	稳定	40-50	稳定	40-50	稳定	20-42	稳定	
存储	SK Hynix	8-12	下降	8-12	下降	8-12	下降	8-12	下降	6-10	根据市场调整	6-10	根据市场调整	
	金士顿	2-6	下降	2-6	下降	2-4	下降	2-4	稳定	2-4	根据市场调整	2-4	根据市场调整	
MOSFET	Infineon	52-65	稳定	40-60	稳定	26-54	稳定	20-52	稳定	18-48	稳定	10-36	根据市场调整	
	ST	47-52	稳定	47-52	稳定	47-52	稳定	47-52	稳定	39-52	稳定	14-40	稳定	
	Diodes	48-54	稳定	48-54	稳定	26-54	稳定	26-54	稳定	18-52	根据市场调整	8-16	根据市场调整	
IGBT	Infineon	39-50	上升	39-50	上升	39-50	稳定	39-50	稳定	39-50	稳定	14-52	稳定	
	ST	47-52	稳定	47-52	稳定	47-52	稳定	47-52	稳定	47-52	稳定	14-52	稳定	
注：	交期延长 价格上升		交期稳定 价格稳定		交期缩短 价格下降									

资料来源：富昌电子、芯八哥整理

2、市场复苏，半导体销售额走出低谷

美国半导体工业协会（SIA）数据预测，2023 年全球半导体销售额约 5200 亿美元，同比下降 9.4%。值得关注的是，截至 2023 年 12 月全球半导体销售额已连续第十个月实现环比增长，芯片需求呈现出明显的回升势头，预计全球半导体市场在 2024 年将强劲反弹。

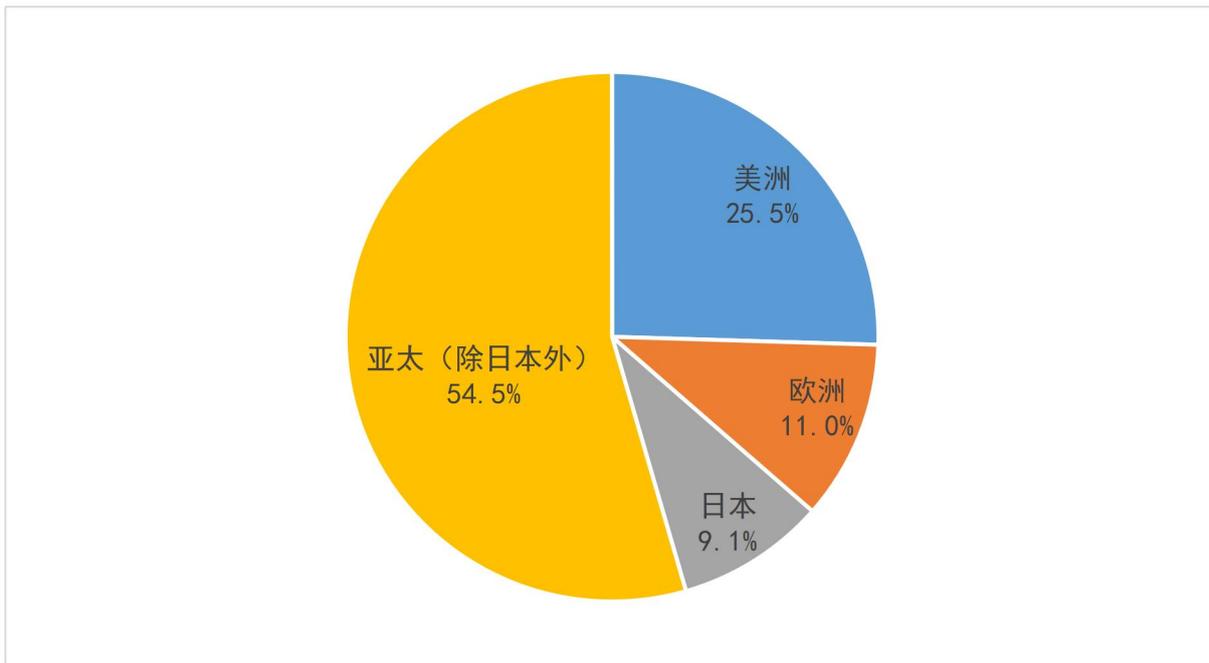
图表 3：2023 年全球半导体销售额情况



资料来源：SIA、芯八哥整理

从区域占比看，世界半导体贸易统计协会（WSTS）最新数据显示，2023 年以中国为代表的亚太地区（不包括日本）仍旧是全球最大的半导体消费市场，占比达 54.5%，其他如美洲、欧洲及日本等分别占 25.5%、11.0%、9.1%。

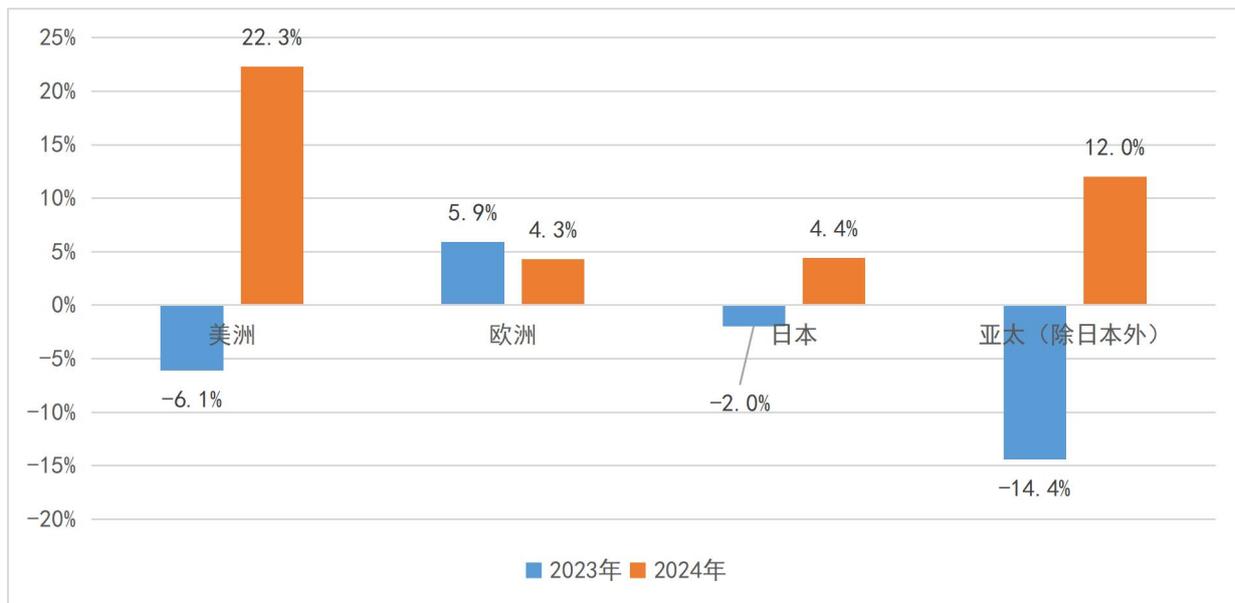
图表 4：2023 年全球半导体区域市场占比



资料来源：WSTS、芯八哥整理

从区域增长情况看，2023 年除欧洲地区约有 5.9% 的小幅增长外，其余地区将面临下滑，其中美洲地区约下降 6.1%，亚太地区下降 14.4%，日本下降 2.0%。

图表 5：2023-2024 年全球半导体区域市场增长情况

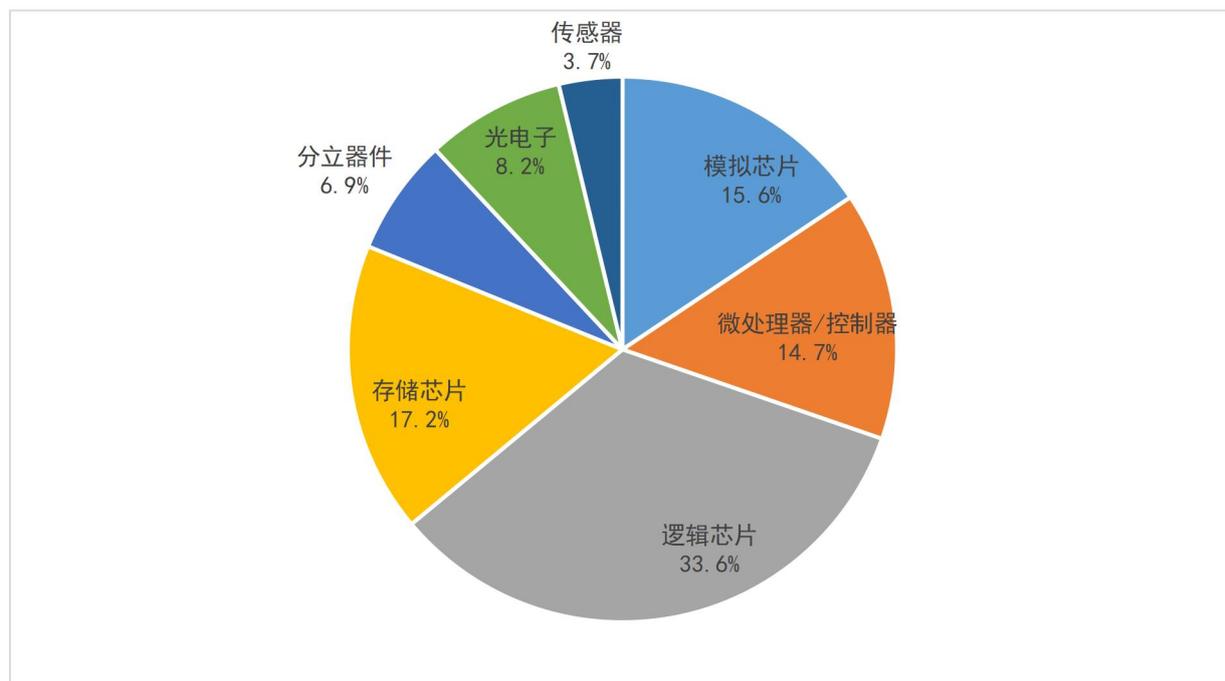


资料来源：WSTS、芯八哥整理

从芯片类型看，2023 年各细分品类均有所下跌。逻辑芯片占比最大，销售额约 1749

亿美元。存储芯片降幅最大，同比下跌 31%，约 896 亿美元。

图表 6：2023 年全球半导体细分产品占比



资料来源：WSTS、芯八哥整理

从头部厂商看，2023 年全球 Top25 半导体供应商总收入同比下滑 14.1%，占整体市场份额约 74.4%，低于 2022 年的 77.2%；Top10 半导体供应商占整体市场份额达 49.3%，低于 2022 年的 53.9%。在 2023 年半导体全行业普遍承压下，Top10 厂商的营收总额有所下滑。其中，三星、SK 海力士等存储厂商普遍收入下跌，AI 需求的快速发展助推英伟达首次进入 Top5 行列，汽车高需求下 ST 进入 Top10 阵营。

图表 7：2023 年全球 Top10 半导体供应商市场份额

2023 年排名	2022 年排名	厂商	2023 年市场占比	涨幅
1	2	Intel	9.1%	-16.7%
2	1	三星	7.5%	-37.5%
3	3	Qualcomm	5.4%	-16.6%
4	6	Broadcom	4.8%	7.2%
5	12	英伟达	4.5%	56.4%
6	4	SK Hynix	4.3%	-32.1%
7	7	AMD	4.2%	-5.6%
8	11	ST	3.2%	7.7%

2023 年排名	2022 年排名	厂商	2023 年市场占比	涨幅
9	9	苹果	3.2%	-5.8%
10	8	TI	3.1%	-12.2%
-	-	其他厂商	50.7%	-8.8%
-	-	总计	100%	-11%

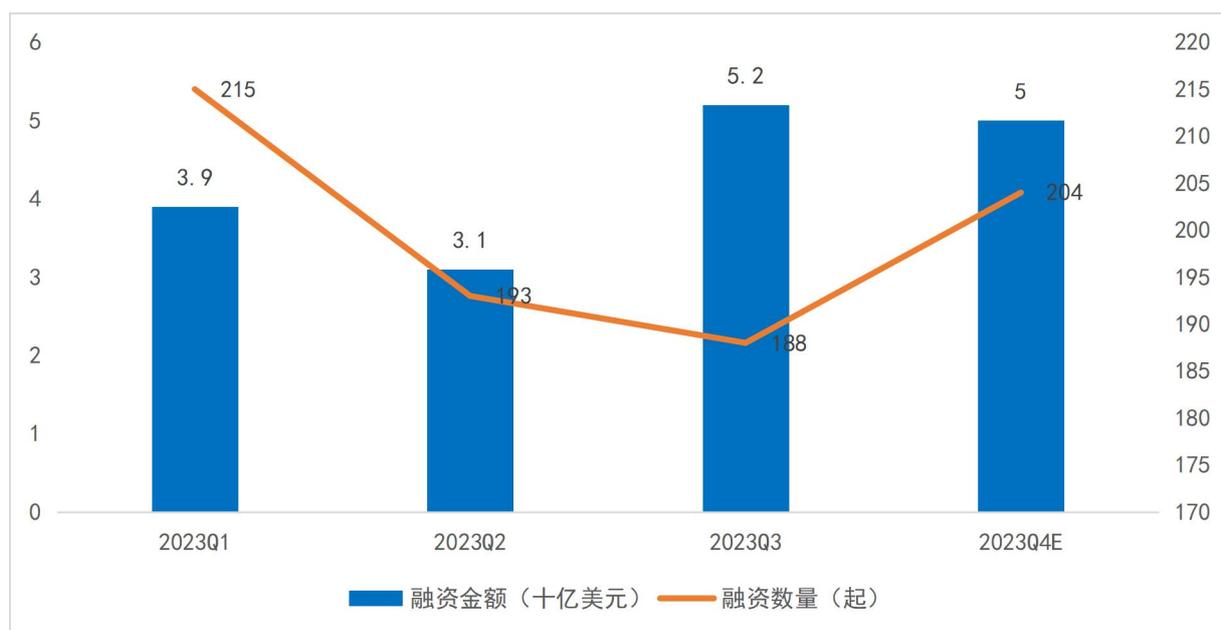
资料来源: Gartner、芯八哥整理

世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 预计, 2024 年全球半导体销售额同比增长 13.1%, 行业将重回上升周期。

3、投资回升, AI 和汽车等成资本热点

2023 年全球半导体投融资事件高达 800 起, 比 2022 年的 1029 起下降 22%; 投融资规模高达 172 亿美元, 相比 2022 年 165 亿美元增长 4%。

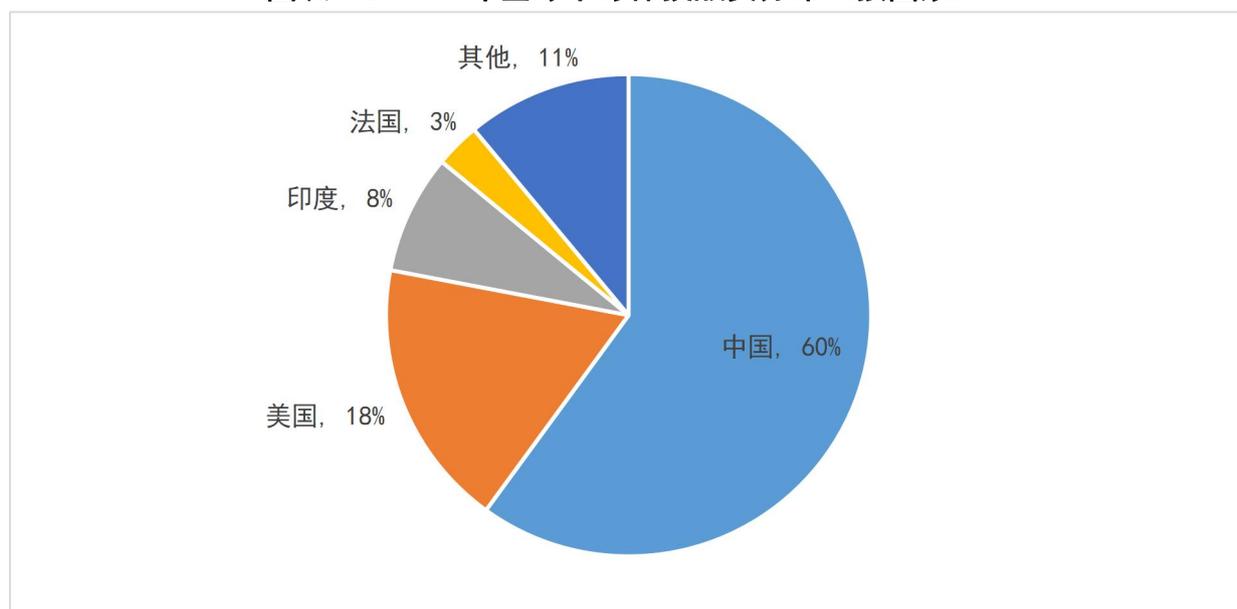
图表 8：2023 年全球半导体投融资情况



资料来源：CB Insights、芯八哥整理

中国依旧是全球半导体投融资活动最活跃的国家。2023 年，全球 60% 的投融资事件来自中国，18% 来自美国。2022 年起，中国、美国、欧洲均计划对半导体投资数百亿美元，搭载半导体设备的数量正不断增加，各国家/地区都在寻求半导体产业链自给自足。

图表 9：2023 年全球半导体投融资分布（按国家）



资料来源：CB Insights、芯八哥整理

从投资方向看，2023 年，众多资本涌向半导体投融资热门赛道，精彩纷呈。晶圆制

造备受关注，功率半导体和射频受益于新材料碳化硅以及汽车、光伏、通信等行业的快速发展，而 AI 硬件、AR/VR 乘 AI 浪潮东风快速崛起，激光雷达已经实现商业化落地。

图表 10：2023 年全球半导体投资热点



资料来源：CB Insights、芯八哥整理

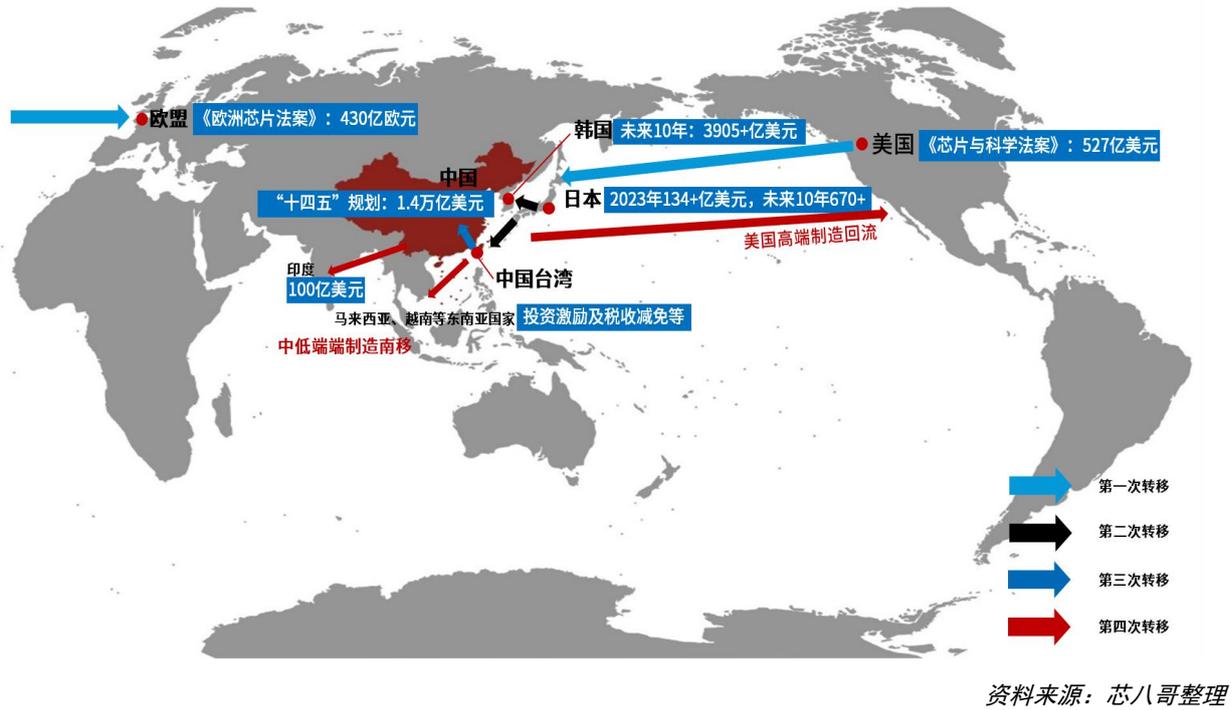
综上，2023 年全球半导体投融资市场前低后高，这显示投资机构对半导体行业的信心正在回升，行业正在逐渐复苏。

4、格局变化，地缘争端引发产业转移

自 1947 年第一支晶体管诞生以来，全球半导体产业主要经历了三次产业转移：第一次从 80 年代开始，由美国转移至日本、欧洲地区等；第二次则在 90 年代末到新世纪初，由日本向韩国和中国台湾地区转移；第三次是 21 世纪初以来，主要由中国大陆承接新一轮的半导体产业转移。

2018 年之后，在多种因素的影响下，全球半导体供应链正在发生着潜移默化的变化。2023 年芯片供应链的波动性比以往更强烈，各国/地区高度重视本土半导体供应链布局。以美国、日本及欧盟为代表积极推动晶圆代工等高端制造业回流，中国部分消费电子代工产业加速向越南、菲律宾及印度等东南亚、南亚国家转移。可以看到，全球半导体产业链上下游正经历新一轮的产业变革，由分工走向分化趋势明显。

图表 11：2023 年全球半导体产业正经历新一轮产业转移



二、2023 年采购分销年度回顾

过去一年，元器件分销行业受半导体周期性调整影响，从巅峰进入低谷，行业正经历激烈的周期性调整，也面临着新的挑战与机会。

1、年度供应链大事件及影响

站在新起点，芯八哥重点梳理了部分影响元器件分销行业的年度代表事件。其中，值得关注的新机会方面，ChatGPT 突破下 AI 相关需求迎来爆发，华为 mate60 系列发布下国产智能手机供应链未来可期。行业风险方面，TI 开启新一轮模拟芯片价格战和存储原厂持续减产保价下对于分销行业波动影响持续；美国对华管制不断升级对供应链冲击加剧。总的来看，2023 年半导体供应链仍负重前行，但相较于 2022 年，行业积极信号不断涌现。

图表 12：2023 年半导体供应链值得关注大事件及影响回顾

类型	时间	事件	影响规模	涉及行业	涉及产品	影响厂商
----	----	----	------	------	------	------

类型	时间	事件	影响规模	涉及行业	涉及产品	影响厂商
需求	2023.02	ChatGPT 突破	850+亿美元	AI 服务器	GPU/CPU/HBM	英伟达、AMD、Intel、SK 海力士等
	2023.11	华为车 BU 独立	150+亿美元	智能汽车	自动驾驶芯片等	华为海思、英伟达等
风险	2023.01	存储大厂减产保价	500+亿美元	存储芯片	Nand-flash、DRAM 等	三星、SK 海力士及美光等
	2023.05	TI 开启价格战	150+亿美元	模拟芯片	PMIC 等	TI、ADI 及 ST
	2023.09	文晔收购富昌	262+亿美元	元器件分销	-	安富利、大联大及中电港等
替代	2023.05	美光在华产品禁售	33+亿美元	存储芯片	Nand-flash、DRAM 等	美光、三星及 SK 海力士
	2023.09	美日荷半导体设备管制落地	350+亿美元	半导体设备	半导体设备等	ASML、AMAT、LAM 等
	2023.08	华为手机回归	650+亿美元	智能手机	SOC、射频芯片、存储等	高通、博通及联发科等
	2023.10	AI 管制升级	100+亿美元	服务器等	GPU 等	英伟达、AMD、Intel 等

资料来源：芯八哥整理

2、头部厂商订单及库存情况

从企业订单及库存看，汽车/AI 服务器订单持续上升，手机/PC 芯片厂商库存下降明显，工业/通信/部分新能源相关库存去化相对缓慢。预计 2024 年 AI 类芯片需求维持高景气度，存储行业有望持续回暖，MCU 订单波动较高，模拟产品需求有所分化，射频相关需求回升。

图表 13：头部企业订单及库存情况

公司	2023 年订单	2023 年库存	2024 年订单趋势	2024 年库存趋势
----	----------	----------	------------	------------

公司	2023 年订单	2023 年库存	2024 年订单趋势	2024 年库存趋势
Intel	下降	一般	稳定	一般
AMD	下降	一般	稳定	一般
NVIDIA	上升	无	上升	无
Samsung	下降	一般	上升	一般
TI	下降	较高	根据市场调整	一般
ST	上升	低	根据市场调整	一般
ADI	稳定	低	上升	一般
Qualcomm	下降	一般	根据市场调整	一般
Broadcom	稳定	一般	根据市场调整	低
NXP	上升	低	根据市场调整	较低
Infineon	上升	低	根据市场调整	较低
Renesas	稳定	低	根据市场调整	一般
onsemi	上升	低	稳定	低
Microchip	稳定	一般	稳定	一般
Micron	下降	一般	上升	一般
SK Hynix	下降	一般	上升	一般
Murata	稳定	低	稳定	稳定
MTK	下降	一般	根据市场调整	一般

资料来源：芯八哥整理

3、重点品牌交期及趋势分析

2023年，车规级和AI相关产品占据年度热度较高的品类；企业方面，NVIDIA需求暴涨，Infineon、NXP及onsemi等厂商需求保持稳定，TI、三星、SK海力士等波动较大，高通、联发科等需求有所复苏。

图表 14：年度市场热点品类及厂商一览

厂商	典型料号	应用领域	备注
TI	TPS 系列等	工控、汽车	需求低迷，价格倒挂严重
ST	STM32F103 系列等	消费电子、汽车	需求稳定，价格下降
ADI	LTM 系列等	通信、汽车	需求分化，价格低位
NXP	FS32K1/TJA 系列等	汽车、工业	需求稳定，价格下降
onsemi	MBRS 系列等	汽车	需求稳定，价格下调
Infineon	FS 系列等	汽车	库存上升，需求稳定
NVIDIA	A100/H100 等	服务器	需求暴涨，价格上升
SK Hynix	HBM3 等	服务器	需求上升，价格上升
Renesas	ISLXX/HDXX/SLGXX 等	汽车	需求稳定，交期改善
Microchip	ATXMEGA128 系列等	工业	需求一般，库存较高
Xilinx	XCKU 系列等	通信、数据中心	需求稳定，价格改善
Qualcomm	8 Gen2/3 等	消费电子	需求回升，库存较高
Broadcom	BCM89 系列等	汽车、服务器	热度较高，成交低迷

资料来源：芯八哥整理

4、年度涨跌幅品类/厂商一览

受终端需求疲软影响，行业陷入库存去化周期，PMIC等模拟芯片、MCU及部分消费类产品成年度跌幅较大的品类。此外，随着交期持续改善，MOSFET等部分车规级产品价格改善明显。

图表 15：年度重点降价品类一览

产品	应用领域	降幅	具体情况	标杆企业
模拟芯片	消费电子、汽车等	10%~30%	库存较高，TI 开启价格战	TI、ADI 及 ST 等
MCU	消费电子、汽车等	5%~20%	交期改善，需求低迷	ST、NXP 及 Infineon 等

产品	应用领域	降幅	具体情况	标杆企业
SOC	消费电子	5%~15%	需求低迷	高通、联发科等
MOSFET	新能源汽车等	5%~10%	交期改善	NXP、ST 及 Infineon 等

资料来源：芯八哥整理

随着 2023 年初 AI 需求爆发，GPU、HBM 芯片及以太网芯片等 AI 相关品类占据年度重点涨价榜单。在三星等头部存储厂商持续减产保价下，2023Q3 以来 DRAM 等存储类产品价格持续回升。

图表 16：年度重点涨价品类一览

产品	应用领域	涨幅	具体情况	代表厂商
GPU	AI 服务器等	>200%	AI 需求爆发	英伟达、Intel 及华为海思等
HBM	AI 服务器等	>75%	AI 需求爆发	SK 海力士、三星及美光等
以太网芯片	AI 服务器、汽车等	12%~45%	AI 及汽车需求增长	博通、Marvell 等
DRAM	消费电子等	5%~23%	减产保价，23Q3 上涨	三星、SK 海力士及铠侠等
NAND Flash	消费电子等	5%~20%	减产保价	三星、SK 海力士及美光等
IGBT	新能源、汽车等	5%~12%	汽车需求增长	Infineon、三菱及 onsemi 等

资料来源：芯八哥整理

综上，2023 年全球半导体行业已走过最艰难的库存去化周期，元器件分销行业也将进入新的复苏阶段。芯八哥建议，面对不稳定的市场环境和供需关系，在实际操作过程中，客户和企业采购人员可以结合自身实际需求和产品市场走势等多方面进行评估。此外，可以尝试通过在华强商城查看相应产品的价格、库存和交期等变化信息，实时应对变化中的风险和机遇。

三、2023 年半导体供应链梳理

2023 年，半导体行业库存去化持续。设备需求稳定，硅晶圆等材料需求低迷，制造环节产能分化，原厂订单不振，终端需求分化。展望 2024 年，库存去化或延至 2024H1，下半年在需求拉动下行业景气度回升。

图表 17：2023 年半导体供应链梳理及 2024 年预测

产业链	细分	2023 年稼动率	2023 年订单	2023 年库存	2024 年订单趋势
支撑环节	设备	高	稳定	一般	稳定
	材料	一般	下降	一般	稳定
制造环节	代工	一般	下降	-	上升
	封测	较低	下降	-	上升

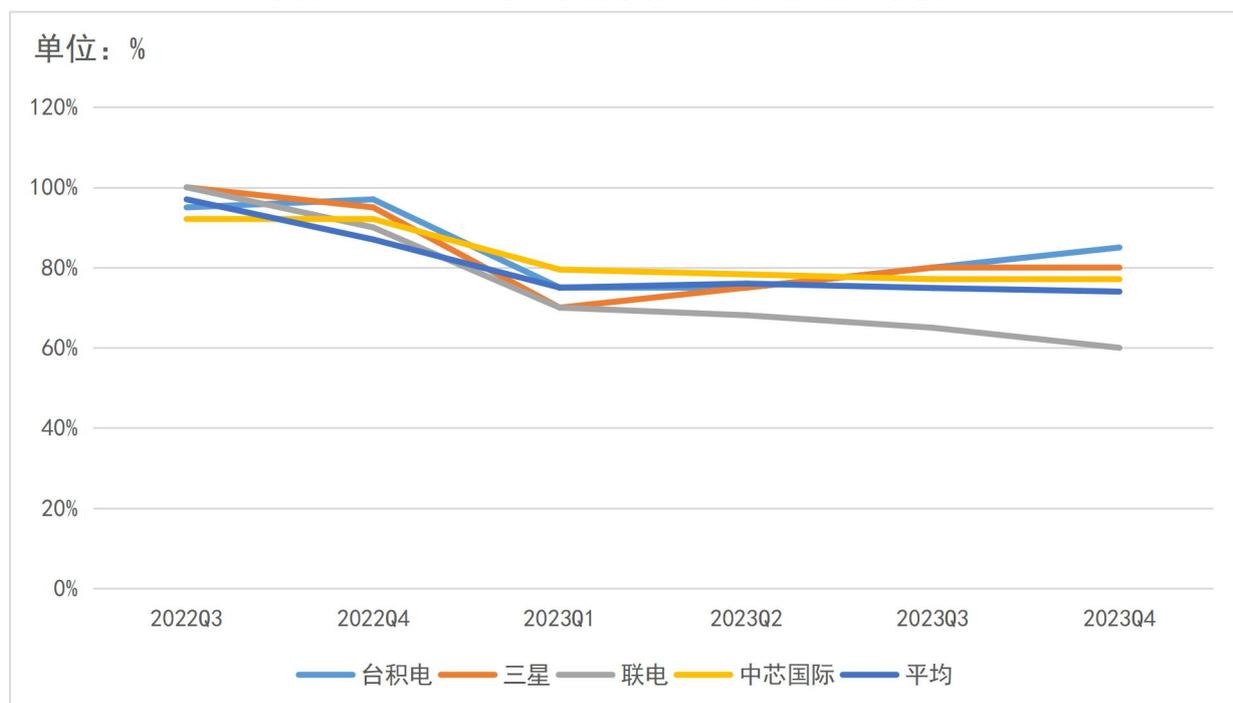
产业链	细分	2023 年稼动率	2023 年订单	2023 年库存	2024 年订单趋势
上游	原厂	稳定	分化	高	稳定
中游	分销	-	下降	较高	上升
下游	消费电子	较低	下降	极高	上升
	汽车	高	上升	低	上升
	工控	低	下降	较高	下降
	家电	一般	下降	高	下降
	光伏	稳定	上升	较高	上升
	储能	高	上升	较高	上升
	通信	一般	下降	较高	下降
	服务器	较高	上升	低	上升

资料来源：芯八哥整理

1、制造：晶圆代工产能分化，先进制程价格上调

受终端需求低迷影响，2023 年全球晶圆代工厂商 8/12 英寸产能利用率低迷，成熟制程价格持续承压。以台积电为例，其 2023Q3 以来产能利用率环比有所回升，但由于终端需求分化，2024 年公司针对成熟制程降价约 2%，7nm 以下代工报价将涨 3%~6%。

图表 18：2023 年主要晶圆代工厂产能利用率情况



展望 2024 年，伴随下游需求平稳复苏，全球晶圆代工呈现小幅度复苏，先进制程（7nm 及以下）量价齐升，成熟制程（16nm 以上，一般 20nm 以上）需求量升价跌。

图表 19：2024 年头部晶圆代工厂价格预测

代工厂	2024 年价格预测	备注
台积电	7nm 以下代工报价将涨 3%~6%	2023 年 8 英寸报价降幅超 10%
三星电子	整体稳定，成熟制程小幅下跌	2023 年成熟制程降价 10%以上
联电	大客户价格折让 5%，最高降幅达两位数	2023 年最高降价达 30%
中芯国际	稳定	国内代工需求支撑
世界先进	降价 5%-10%	应对价格竞争形势，会弹性调整
力积电	降价 4%-5%	为提升产能利用率，将扩大降价
华虹	降价	为提升产能利用率，考虑降价

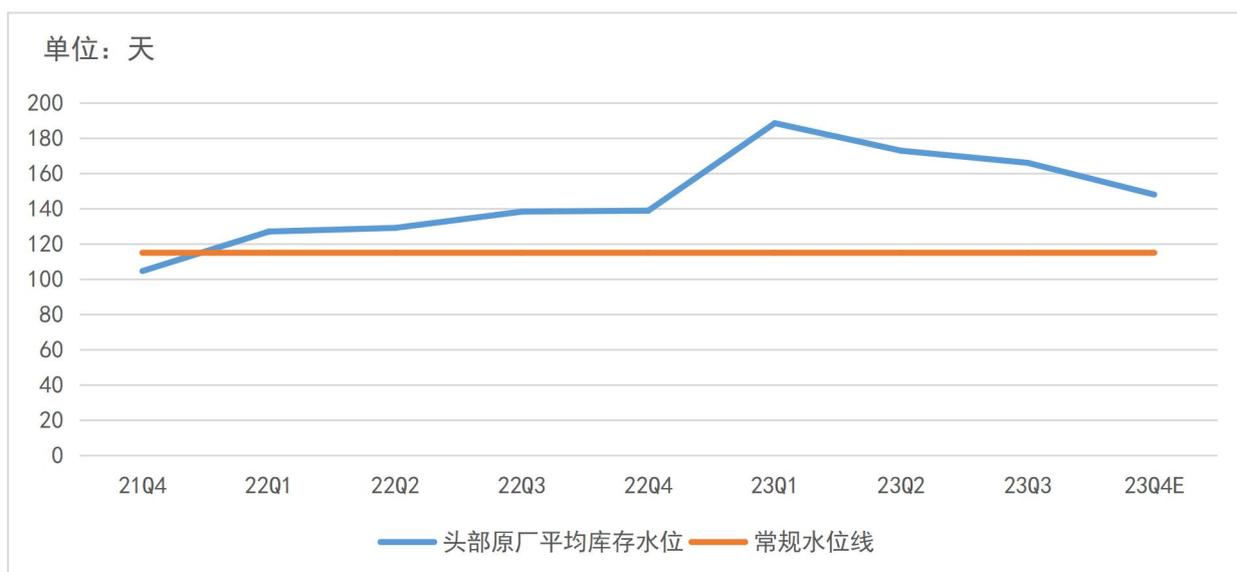
资料来源：芯八哥整理

此外，2024 年晶圆代工下游客户库存去化结束，需求及政策或成为未来发展核心驱动力。需要关注通货膨胀、区域竞争、生产制造本土化等因素将持续影响全球半导体代工市场。中国市场聚焦成熟工艺发展，美国在先进工艺布局最为积极，欧洲、日本积极扩大半导体产业链投资等。

2、原厂：库存触底反弹，存储产品价格持续改善

根据全球主要的半导体厂商最新财报及预测梳理，自 2023Q2 以来，整体库存已连续三个季度降幅明显，虽然仍处于较高水平，但基本可以确定全球半导体产业逐渐走出低谷期，触底反弹明显。

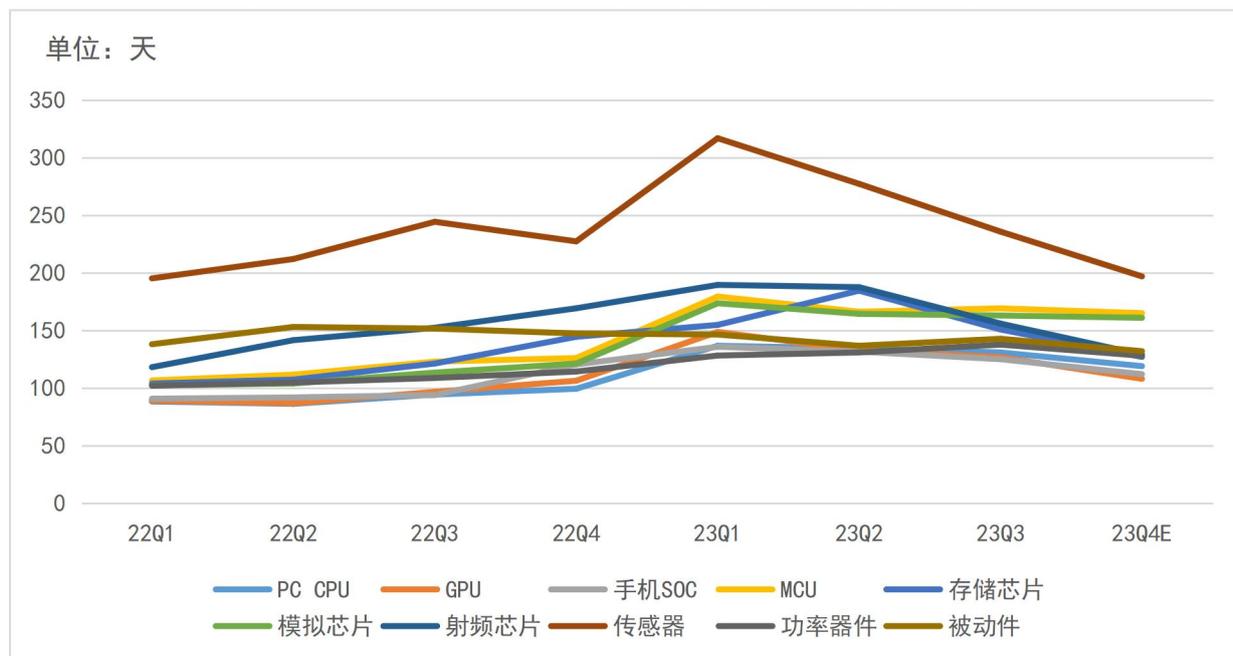
图表 20：头部原厂库存 2023Q1 触顶下滑



资料来源：芯八哥整理

通过全球半导体各品类头部厂商平均库存对比梳理发现，2023 年存储芯片、射频芯片和传感器库存降幅最大，MCU 和功率器件波动比较明显，CPU 和手机 SOC 小幅改善，模拟芯片未见转好。

图表 21：2022Q1-2023Q4 各品类厂商平均库存走势图



资料来源：芯八哥整理

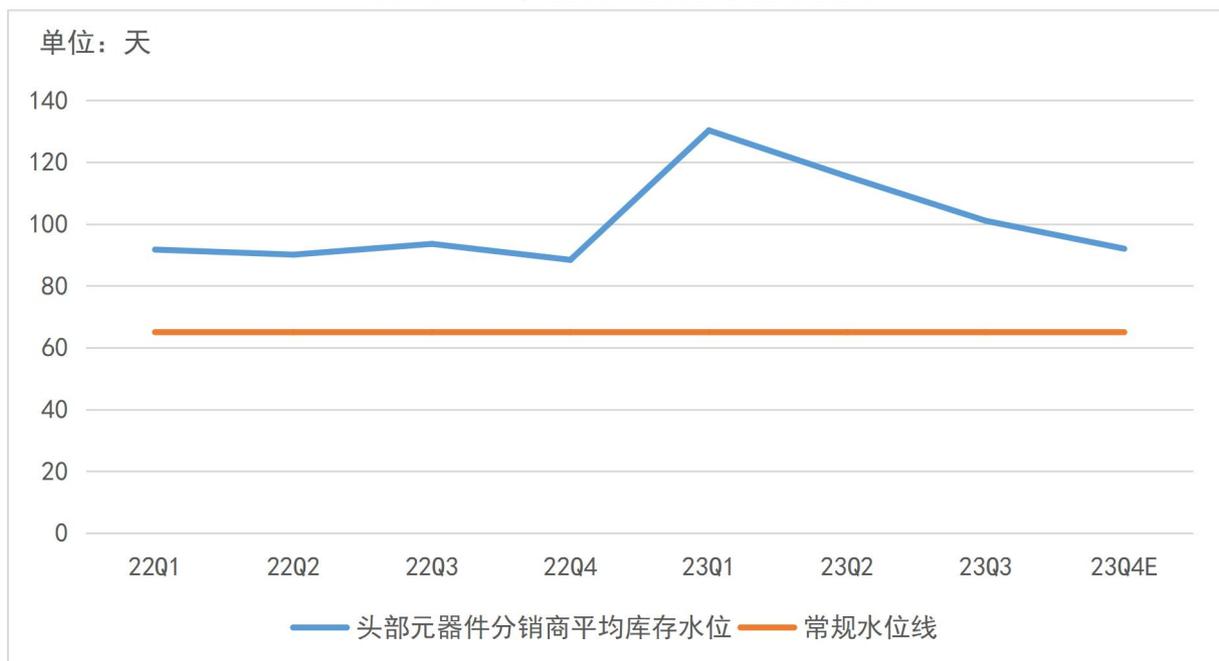
综上，2023 年全球半导体复苏趋势明显，Q1 是行业低谷，Q2 行业持续回升，但整体

库存仍维持高位，谨慎关注头部厂商最新发展动态。

3、分销：整体库存相对较高，营收回升趋势巩固

元器件分销作为原厂和终端客户中间重要的枢纽，由于利润微薄，其对于市场的供需变化的敏感度异常之高。2023Q1 元器件分销行业平均库存达到高点，随后呈现逐步向好态势。但从主要厂商平均库存天数看，相较于常规库存水位线整体库存仍处于较高水平。芯八哥结合最新分销商财报预测分析，一直到 2024H1 仍属于行业库存去化及供需调整的振荡期，从业者需谨慎关注其中蕴含的风险及潜在机遇。

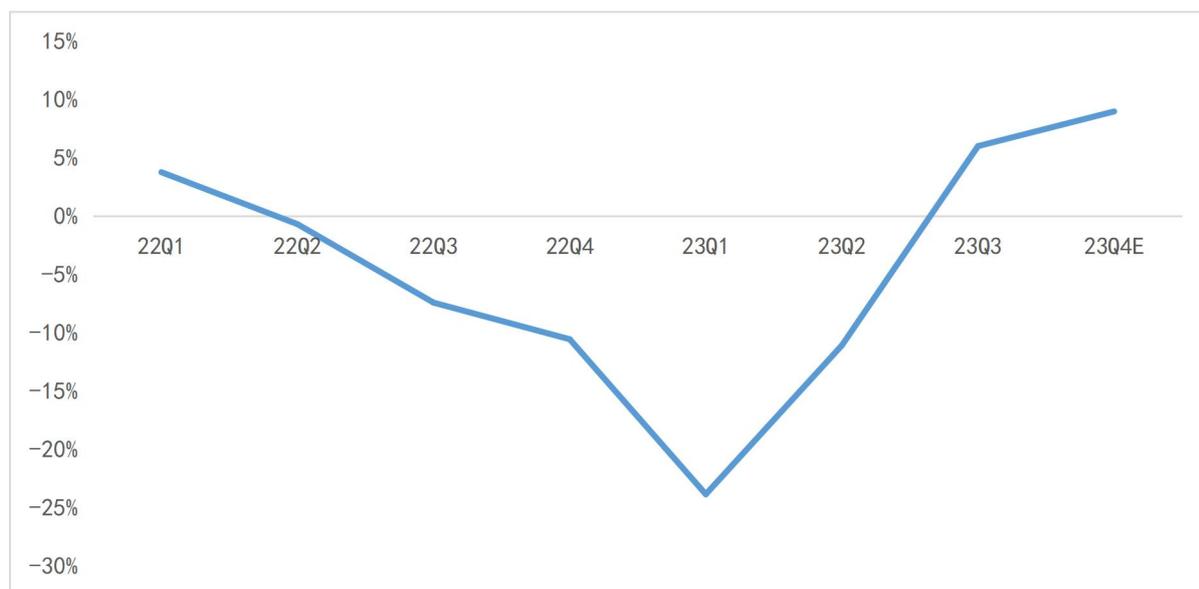
图表 22：头部分销商库存相对较高



资料来源：芯八哥整理

从营收情况看，在经历了 2022 年下半年以来的持续负增长后，2023Q1 行业触底，Q2 开始逐步复苏，Q3 行业增速会逐步回正，显示持续已久的元器件分销行业恢复增长态势。芯八哥判断，元器件分销行业持续接近一年的下行周期结束，行业迎来新的复苏阶段。

图表 23：2023Q3 以来头部分销商营收同比增速持续回正

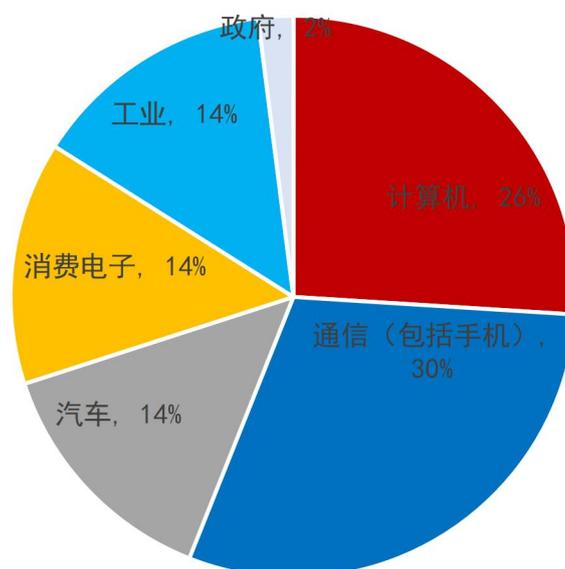


资料来源：芯八哥整理

4、终端：需求呈现两级分化，看好 AI 和汽车增长

从半导体终端需求占比看，体量巨大的 PC、智能手机等消费电子是市场增长的关键，汽车、新能源及 AI 服务器等将决定未来市场增长的上限。

图表 24：全球半导体终端应用中消费类需求占大头

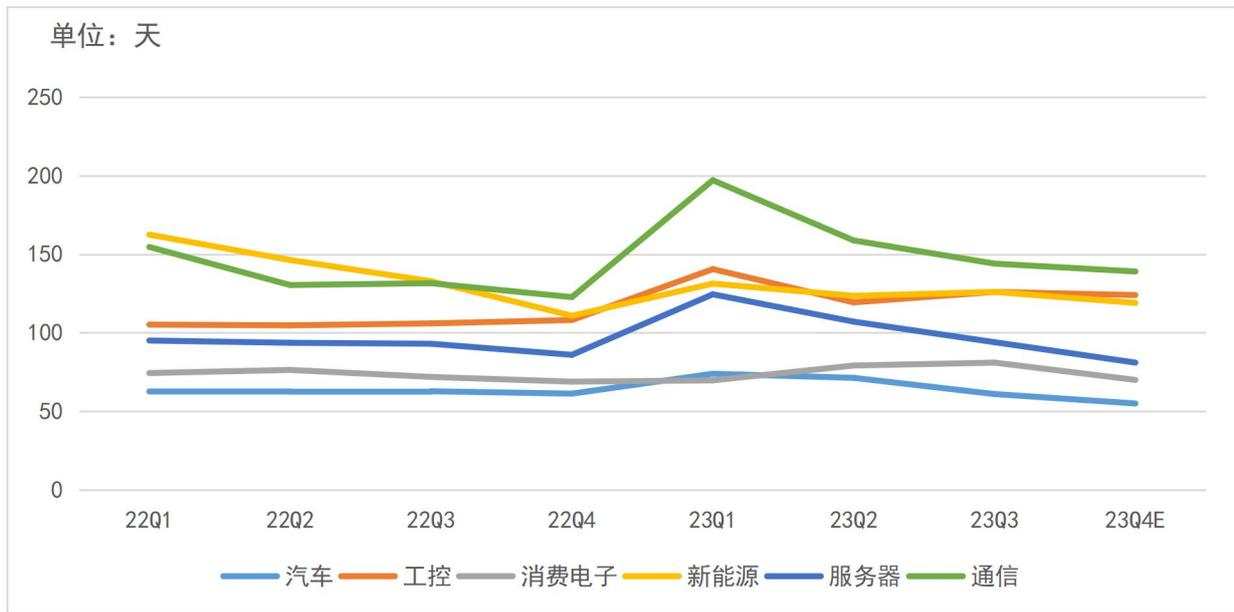


资料来源：WSTS

结合终端厂商 2023 年库存走势看，整体库存改善明显。其中，消费电子库存改善，市场复苏明显；汽车、服务器等增量市场库存相对健康，需求增长良好；新能源库存相

对较高，行业需求存在一定波动；工业、通信库存仍有反复，增长或存在较大压力。

图表 25：终端应用厂商平均库存走势及预测



资料来源：芯八哥整理

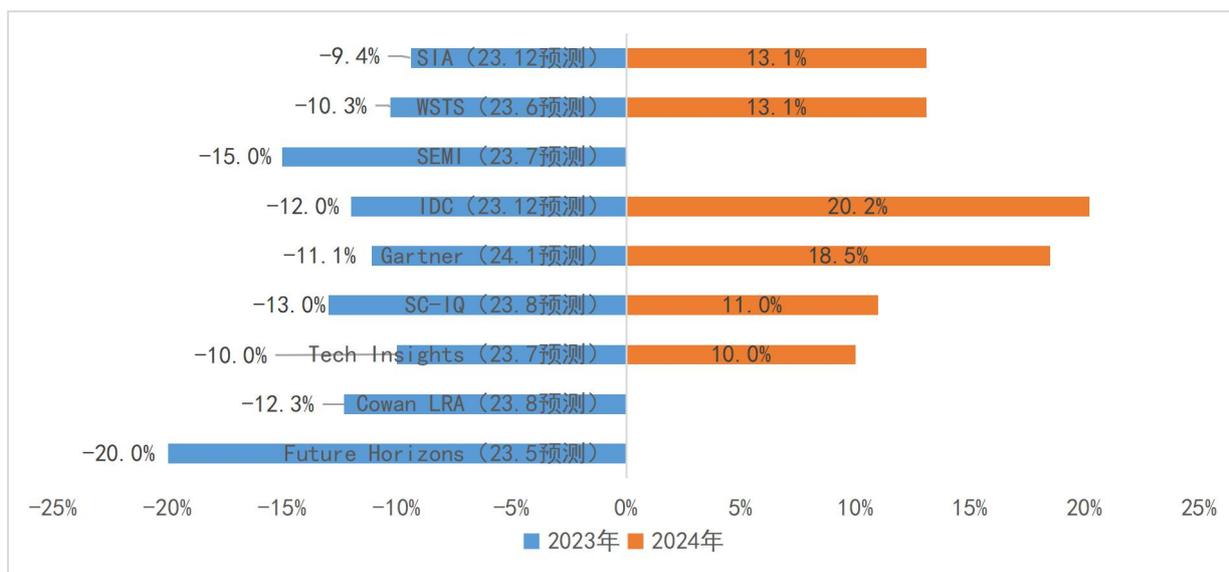
综上，2023 年消费类产品需求持续复苏，电动汽车和 AI 相关需求维持高速增长，新能源增长预期良好，工业和通信国产替代加速，供应链迎来改善周期，2024 年或将成为行业上升周期的起点。

四、2024 年趋势展望

1、半导体销售恢复中高速增长，存储成关键

从全球半导体销售额看，2023 年半导体行业筑底已基本完成，从 Q3 厂商连续数月的稳定增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上调 2024 年全球半导体销售额预测，2024 年芯片行业将出现 10%-18.5% 之间的两位数百分比增长。其中，IDC 和 Gartner 最为乐观，分别预测增长达 20.2% 和 18.5%。

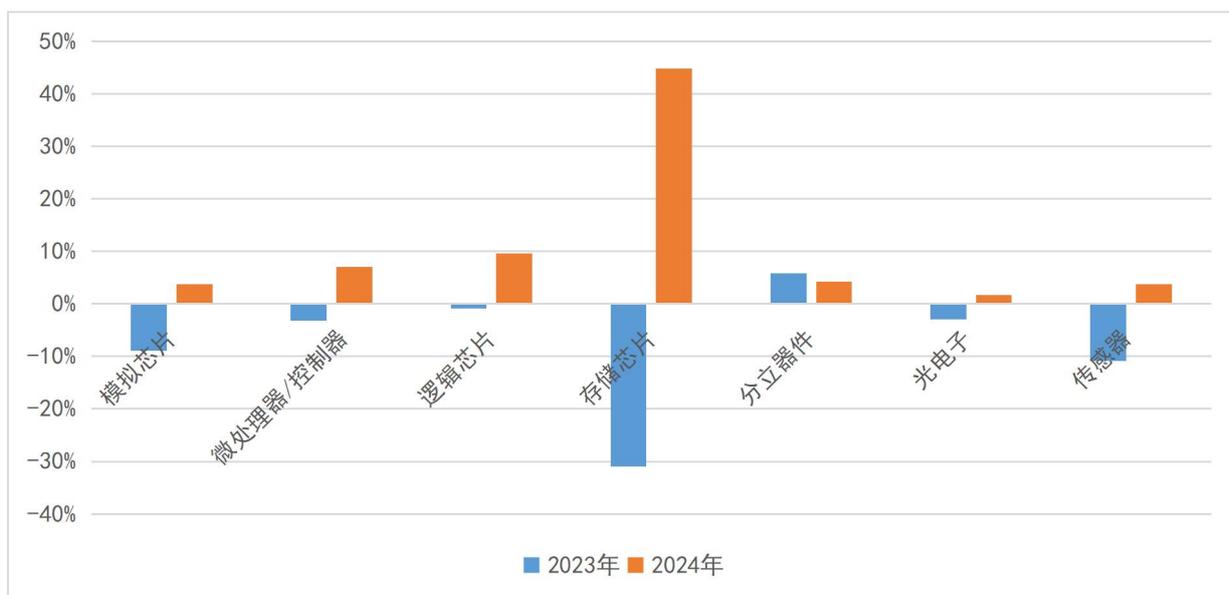
图表 26：2024 年全球半导体销售额增长预测



资料来源：芯八哥整理

从细分品类看，WSTS 预计 2024 年增速最快的前三名是存储、逻辑和处理器，分别增长 44.8%、9.6%和 7.0%。其他品类中，光电子增速最低，约 1.7%；模拟芯片受库存去化及需求低迷影响，增速约 3.7%。总的来看，存储产品或将成为 2024 年全球半导体市场复苏关键，销售额有望恢复 2022 年水平。

图表 27：2024 年全球半导体细分品类增长预测



资料来源：WSTS、芯八哥整理

2、看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势

综合重点细分市场发展空间及前景，2024 年，预计智能手机和 PC 等消费电子有望实现小幅增长，新能源汽车、新能源及 AI 服务器等将保持高速增长态势，家电、通信和工业等需求持续回升。随着苹果 MR 新品发布，关注元宇宙发展潜力。

图表 28：2024 年主要终端应用领域增长预测

细分	2024 年全球增速预测	2024 年中国增速预测	中国市场占比
储能	75.6%	92%	37.2%
电动汽车	58.3%	29.4%	68.3%
光伏	24%	30.8%	46.9%
工控	7.8%	10.8%	28.4%
AI 服务器	19.5%	19%	36.6%
通信	3%	5%	26%
智能手机	4.5%	8.8%	24%
PC	3.6%	7.9%	19%
家电	3.2%	4%	38%
AR/VR	44.2%	37.5%	15%

资料来源：IDC、中金公司、Wind、芯八哥整理

3、分销行业集中度提升，强者恒强趋势凸显

元器件分销商作为半导体供应链中的蓄水池，随着近年来分销市场规模逐年扩大，行业市场份额呈头部集中效应。其中，艾睿电子、安富利、大联大和文晔等 TOP4 分销商市场份额占比从 2020 年的 46.52% 增至 2023 年约 54%，TOP10 分销商市场份额占比从 2020 年的 65.15% 增至 2023 年约 71%，行业“大者恒大、强者恒强”格局显现。

图表 29：2020-2023 年元器件分销行业头部厂商份额占比变化



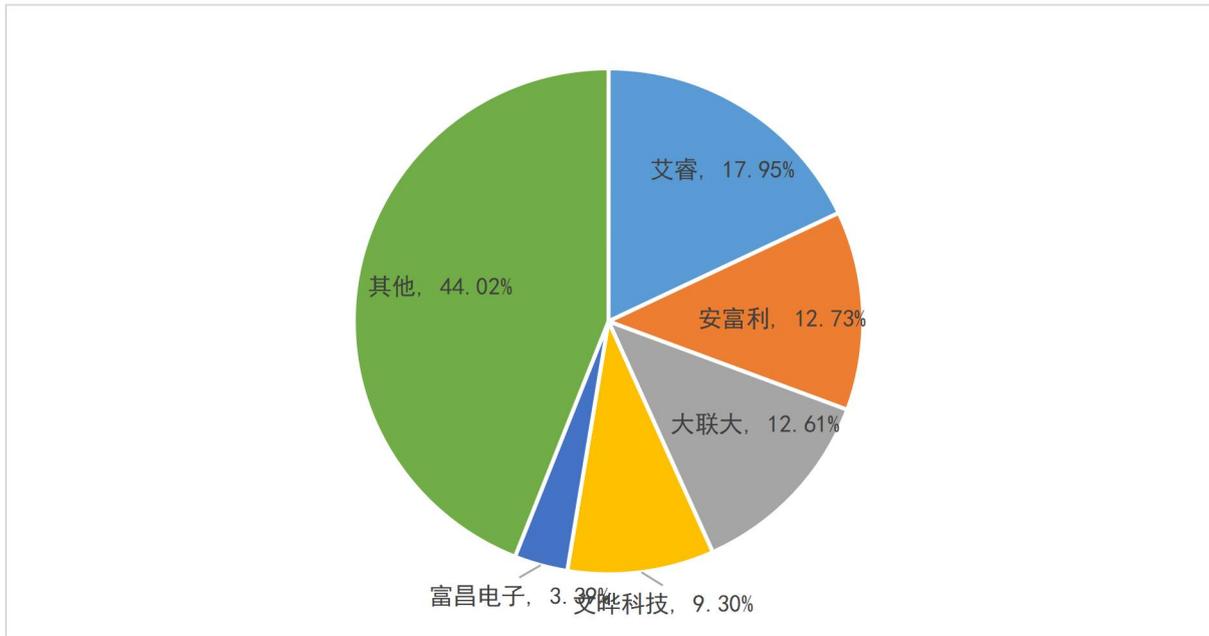
资料来源：Gartner、大联大、ESM、芯八哥整理

4、供应链波动风险持续，分销并购整合加速

近两年，在全球半导体供应链风险加剧、渠道变革提速、授权资质竞争激烈及行业营收下滑等背景下，头部电子元器件分销商凭借资金实力和授权资源丰富等多重优势，持续通过兼并收购方式，向综合技术及供应链服务商转变，进一步扩大市场份额，逐步完成现有业务格局。

其中，2023 年文晔科技 38 亿美元收购富昌电子 100% 股份后，市场份额合并达 12.69%，超过大联大的 12.61% 跃居全球元器件分销第三位。国内市场方面，近几年深圳华强、英唐智控等上市公司亦先后完成了对多家电子元器件分销商的收购，从而实现了营业收入的快速增长。总的来看，分销行业正迎来加速洗牌阶段。

图表 30：元器件分销 TOP5 厂商份额占比



资料来源：大联大、ESM、芯八哥整理

免责声明

本文由华强电子网集团旗下媒体芯八哥®内容团队整理，观点仅代表作者本人，芯八哥®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本刊提醒读者，本报告内容及观点仅供学习参考，不构成任何投资及应用建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

华强电子网集团旗下媒体芯八哥

2024 年 1 月

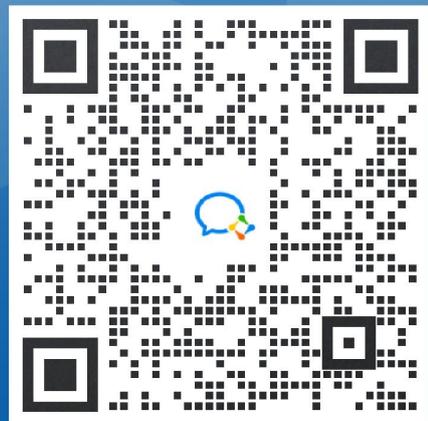


<<< 扫码关注“芯八哥”

及时获取更多半导体市场采购及销售情报、
厂商动态和行业趋势报告

加入芯八哥半导体行业交流群 >>>

群内每日分享行业前沿资讯，还有精品报告、
行业白皮书免费领取





更高效 更透明 重构产业生态

仓储服务 元器件采购 信息服务 API/FTP
PCB制板 BOM工具 SAAS

www.hqengroup.com

深圳总部

电话：86-755-83396000

传真：86-755-26421633

地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦
B座4、7、12楼